新製品 新技術紹介

切削加工技術における Innovation となる

「SiC 単結晶工具の開発 | 渉

ビーティーティー株式会社 代表取締役社長 **〒** 463-0808 名古屋市守山区花咲台二丁目 801 番地 TEL: 052-736-8441 FAX: 052-736-8443

URL: http://www.btt.co.jp

本年度の名古屋市工業技術グランプ リにおきまして我々の研究開発事業が 「名古屋市長賞」をいただきました。

この研究開発は名古屋工業大学と共 同研究中のもので切削加工分野に新たな 技術革新を起こすものと考えています。

会社概要

弊社は1988年より切削工具の再研 メーカーとしてスタートし29年目を 迎えます。現在は切削工具の再研削を 通して培った技術で高性能工具の開発 や工具研削盤等の工作機械に加え工具 測定機なども開発販売しております。

研究開発概念

金属と半導体炭化ケイ素(SiC)単 結晶を接触させた際に相互に電子のや りとりが少ない事を利用した新規の精 密加工用刀具の開発。

研究内容

SiC 単結晶はダイヤモンドに次ぐ硬 度を持ち、耐摩耗性など多くの点で優 れた材料である。本研究は、従来の焼 結製法で作られた工具材料や高硬度被 膜の付加等による工具開発ではなく

SiC 単結晶を切れ刃先に搭載した新規 の切削工具を開発し難削材等の高精度 かつ高能率加工を目指すものである。 図1はSiC単結晶を搭載した旋削用 チップである。

開発の背景

航空宇宙分野では機体やエンジン部 品において耐熱合金の Ni 基合金やチ タン合金が多く使用されている。しか し、Ni 基合金に代表されるインコネ ル、ハステロイ等やチタン合金(6Al-4V チタン) は難削材と呼ばれる程、 加工性が悪く、工具寿命の早期低下に 加え、加工時間も非常に長くかかる。 また、近年の自動運転制御装置に組み 込まれる部品に多く使用されている純 鉄、純銅なども切削加工が困難で加工 部品の精度低下が問題になっている。

この原因は、加工する切削工具の切 れ刃エッジ部分が凹凸であるため、切 削抵抗が増加し切削界面には、被削材 のせん断破壊で発生したエネルギー が、切削工具先端の温度の急激な上昇 を引き起こし切削工具の摩耗が促進さ れる。その結果、切削された材料加工 面には大きな加工歪が発生する。

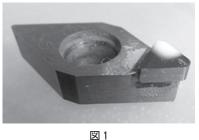
このような切削時におきる様々な問 題を解決するため、我々は2008年に 希少金属(レアメタル)代替材料の研 究を開始し、新規工具材料として、炭 化ケイ素 (SiC) 単結晶の研究開発を 行っています。同年、SiC 単結晶成長 装置を導入しSiC単結晶のドーピン グ付加成長法の研究を開始しました。

研究成果

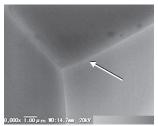
2010年に戦略的基盤技術高度化支 援を受け SiC 単結晶を切れ刃先に搭 載した難削材用切削工具を開発しチタ ン合金加工時の内部残留応力(切削の 際に発生するひずみ等の金属疲労)を 分析した結果、SiC 単結晶工具を使用 した切削加工では切削後の被削材に変 形が見られない事で残留応力が発生し ていないことが確認できた。

さらに新形状のSiC ドリルはCFRP 材の穿孔実験で切削性、加工精度共に 飛躍的に改善でき CFRP 内部の加工 変質を抑制できる事、さらに切削現場 で大きな問題となっていた切り屑の飛 散による被害を抑制できることで大幅 な環境改善が望めるなど CFRP 材の 穿孔加工上の問題を解決できた。2014 年、新ドーピング SiC 単結晶(図2) において、CMP 加工により刃先丸み を20ナノメートル以下の鋭利化に成 功した。(図3) 2015年、医療分野に おける人体細胞の薄膜化に対応できる SiC 単結晶の医療用ナイフ(図 4)

及びプラスティックレンズの超精密 加工用SiC単結晶工具を開発中である。







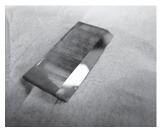


図 3